特集/多様なものづくりを支える粉体工学の進歩

金属粉末光造形複合加工技術による金型の製作 一金属粉末の熱伝導率の測定—

Additive Manufacturing Method of Metal Powder Combining Laser Fusing and Milling Technique – Thermal Conductivity of Metal Powder –

上田 隆司 Takashi UEDA

名古屋大学 特任教授 Designated Professor, Nagoya University

Abstract

The thermal conductivity of metal powder which is used for additive manufacturing is investigated theoretically and experimentally. The theory of instantaneous point source of heat is used to derive the equation to calculate the thermal conductivity of metal powder. Using this equation, the thermal conductivity of chromium molybdenum steel, copper, and nickel powders are obtained experimentally.

1. はじめに

金属粉末光造形では、50µm 程度の薄い層状に供給した金属粉末にレーザ光を照射して選択的に結合させながら積層することにより、三次元物体を造形することができる。ところが、レーザ光を照射する造形では、ビーム走査精度や粉体の粒径などの影響から形状・寸法精度を100µm以下にするのは難しい。そこで、同じ工作機械内でエンドミル加工を併用する複合加工を行うことにより10µmオーダーの精度にまで改善することが出来る。このとき、エンドミルには直径0.5mm 程度の極めて小径のボールエンドミルを用いている。したがって、金属粉末光造形複合加工技術は、レーザ照射によって金属粉末を溶融して結合することにより必要な強度を持たせ、エンドミル加工によって必要な精度を作り出すことができる造形法と言える。

2. 金属粉末

金属粉末光造形では金属粉末の選択が最も重要であ

表1 金属光造形用粉末材料

図1

番号	材質	平均粒径	粒子形状	密度	比表面積
		μm		g/cm ³	m²/g
単体粉末					
1	クロムモリブデン鋼(鉄)	30	球形		
2	クロムモリブデン鋼(鉄)	10	球形		
3	クロムモリブデン鋼(鉄)	20	ややいびつ	3.99	0.42
(4)	クロムモリブデン鋼(鉄)	10	ややいびつ	4.09	0.66
5	ニッケル	30	球形		
6	ニッケル	10	球形		
1	銅合金	30	球形		
8	銅合金	10	球形		
混合粉末					
9	混合粉末-1	30			
10	混合粉末-2	30			
11	混合粉末-3	30			
12	混合粉末-4	10			



100 µm 金属粉末の SEM 画像 る。表1に用いた粉末の一例を示す。粒径が10μm から30μmの鉄(クロムモリブデン鋼), 銅, ニッケ ルを用いており, 焼結用の材料としてはこれらの粉末 を重量比で鉄70%, 銅20%, ニッケル10%を混合 (SCM 混合材)して用いている。図1に用いた混合粉 末の SEM 写真を示す。

金属粉末の薄い層にレーザ光を照射して造形するこ とから,照射条件を検討する際には,粉体の物性を知 っておくことが重要である。

2.1 熱伝導率と吸収率の理論的検討^{*)}

2.1.1 基礎式

図2に示すように、半無限体の物体表面上に(a) 点熱源、及び(b)半径aの円板熱源が存在し、ある 有限時間 Δt の間加熱している状態を考えよう。すな わち、実験状態を表す(b)円板熱源を理想的な状態 である(a) 点熱源と見なすことができる条件につい て検討している。



[Conduction of Heat in Solid]¹⁾ \mathbb{C} \mathfrak{L} \mathfrak{n} \mathfrak{l} ,

(i)瞬間点熱源による加熱によって,加熱開始から の時刻*t*における深さ*z*での温度上昇は

$$(T - T_0) = \frac{Q}{4(\pi \kappa t)^{3/2}} \exp(-\frac{z^2}{4\kappa t})$$
(1)

ただし、 T_0 :室温, $\kappa = K/\rho C$:温度伝導度 (m²/s), K:熱伝導率 (W/mK)、 ρ :密度 (kg/m³), C:比熱 (J/kgK)、 $Q\rho C$:発熱量 (J) で与えられる。

(ii) 瞬間円板熱源による加熱によって,時刻 *t* にお ける深さ z での温度上昇は

$$(T - T_0) = \frac{q}{(\pi \kappa t)^{1/2}} \left[1 - \exp\left(-\frac{a^2}{4\kappa t}\right) \right] \exp\left(-\frac{z^2}{4\kappa t}\right) (2)$$

ただし、a: 円板の半径 (m)、 $\pi a^2 a = Q$.

(iii)連続点熱源による有限時間∆tの間の加熱によって、時刻tにおける深さzでの温度上昇は

$$(T - T_0) = \frac{q}{2\pi\kappa z} erfc \frac{z}{\sqrt{4\kappa t}}$$
(3)

ただし、 $q\rho C \Delta t = Q\rho C$:全熱量(J)、 $q\rho C$:単位時間当たりの発熱量(J/s) で与えられる。

なお,式(1)~(3)において, $Q \approx q$ が意味するところに注意してほしい。

2.1.2 有限の大きさを持つ円板熱源を点熱源と見な しうる条件

式(1)より

$$\begin{bmatrix} \frac{d(T-T_0)}{dt} \end{bmatrix}_{z=const.} = -\frac{3}{2} \frac{Q}{4(\pi\kappa t)^{3/2}} \frac{\exp\left(\frac{-z^2}{4\kappa t}\right)}{t} + \frac{Q}{4(\pi\kappa t)^{3/2}} \frac{z^2 \exp\left(\frac{-z^2}{4\kappa t}\right)}{4\kappa t^2}$$
(4)

 $d(T-T_0)/dt=0$ のとき $(T-T_0)$ は最大となることから、式(4)を用いると、最大温度差が生じる時刻 t_m は、

$$t_m = z^2 / 6 \kappa \tag{5}$$

そのとき、(T-T₀)の最大値は次式であえられる。

$$(T - T_0)_{max} = \frac{Q}{4\left(\frac{\pi z^2}{6}\right)^{5/2}} \exp(-1.5) = 0.147 \frac{Q}{z^3} \quad (6)$$

次に,熱源の大きさ*a*に対して,温度を計測する深 さ*z*をどのように設定すべきか,すなわち,(*z/a*)の 満足すべき条件について検討してみる。式(2)より,

$$\begin{bmatrix} \frac{d(T-T_0)}{dt} \end{bmatrix}_{z=const.}$$

$$= -\frac{q}{(\pi\kappa t)^{1/2}} \frac{1}{2t} \left[1 - \exp(\frac{-a^2}{4\kappa t}) \right] \exp(-\frac{z^2}{4\kappa t})$$

$$+ \frac{q}{(\pi\kappa t)^{1/2}} \left[\frac{-a^2}{4\kappa t^2} \exp\left(\frac{-a^2}{4\kappa t}\right) \right] \exp(-\frac{z^2}{4\kappa t})$$

$$+ \frac{q}{(\pi\kappa t)^{1/2}} \left[1 - \exp\left(\frac{-a^2}{4\kappa t}\right) \right] (-\frac{z^2}{4\kappa t^2}) \exp(-\frac{z^2}{4\kappa t})$$
(7)

 $(T-T_0)$ が最大となる時刻 t_m は,式(7)=0とおく

ことにより得られる。すなわち,

$$\frac{z^2}{4\kappa t} = \frac{1}{2} + \frac{a^2}{4\kappa t} \frac{\exp\left(\frac{-a^2}{4\kappa t}\right)}{1 - \exp\left(\frac{-a^2}{4\kappa t}\right)}$$
(8)

ここで、式(8)の右辺において

$$\frac{a^2}{4\kappa t} \frac{\exp\left(\frac{-a^2}{4\kappa t}\right)}{1 - \exp\left(\frac{-a^2}{4\kappa t}\right)} = f\left(\frac{a^2}{4\kappa t}\right)$$

とおくと,次のような計算結果が得られる。

a^2		
$\overline{4\kappa t}$	f	
1	0.58	
0.5	0.77	
0.2	0.90	
0.1	0.95	

この結果より、もし、 $(a^2/(4\kappa t)) < 0.1$ なら、その時 $f = 0.95 \cong 1$ とおくことができ、 $(T - T_0)_{max}$ を与える時間 t_w は式(8)より、

$$\frac{z^2}{4\kappa t} = \frac{1}{2} + 1$$

となり、次式が得られる。

$$t_m \coloneqq \frac{z^2}{6\kappa} \tag{9}$$

式(9)は式(5)と同じになることから、 $(a^2/(4\kappa t)) <$ 0.1 が満足すべき条件であり、 $t = t_m = z^2/6\kappa$ を代入して整理すると、

$$\frac{z}{a} > 3.87$$
 (10)

が得られる。

2.1.3 有限の加熱時間を瞬間熱源として扱えるため の条件

最高の温度上昇に到達するまでの時間 t_m に対して, どのような条件を満たすとき有限の加熱時間 Δt を瞬間とみなすことができるであろうか?

図3に示す熱源に対して式(3)を適用すれば,温度 上昇は次式で与えられる。

$$(T-T_0) = \frac{q}{2\pi\kappa z} \operatorname{erfc}\left(\frac{z}{\sqrt{4\kappa t}}\right) - \frac{q}{2\pi\kappa z} \operatorname{erfc}\frac{z}{\sqrt{4\kappa(t-\Delta t)}}$$
(11)



そこで、有限の加熱時間 $\Delta t = \beta t_m$ とおき、かつ最大の温度上昇となる時刻 $t = t_m = z^2/6\kappa$ を代入すると、式(11) は次のようになる。

$$(T-T_{0})max = \frac{q}{2\pi\kappa z} [erfc(\sqrt{1.5}) - erfc(\frac{\sqrt{1.5}}{\sqrt{(1-\beta)}})] = \frac{3}{\pi} \frac{Q}{\beta z^{3}} [erfc(1.225) - erfc(\frac{1.225}{\sqrt{(1-\beta)}})]$$
(12)

 $\beta ≤ 0.1$ のとき, すなわち, 加熱時間 Δt が最高温度 到達時間 t_m に比べて十分小さいとき,

$$\begin{aligned} &(T - T_0) \max \\ & \approx \frac{3}{\pi} \frac{Q}{\beta z^3} [erfc(1.225) - erfc(1.225 + 0.612\beta)] \\ & \approx \frac{3}{\pi} \frac{Q}{\beta z^3} [\frac{2}{\sqrt{\pi}} (\exp(-1.225^2) \times 0.612\beta] \\ & = \frac{3}{\pi} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \exp(-1.225^2) \times 0.612 \frac{Q}{z^3} \\ & = 0.147 \frac{Q}{z^3} \end{aligned}$$
(13)

この結果は式(6)と同じ結果となっている。したが って、 $\beta \leq 0.1$ を満たすとき有限の加熱時間 Δt を瞬間 とみなすことができる。

2.1.4 計算結果のまとめ

以上の計算結果より,

$$\beta \le 0.1, \quad a^{2/4} \kappa t < 0.1, \quad z/a > 4$$
 (14)

これらの3つの条件を満足すれば、円板熱源を瞬間 点熱源と見なすことができ、 $(T-T_0)_{max}$ に到達する時 刻 t_m を測定することにより、熱伝導率Kは式(5)か ら

$$K = \frac{z^2}{6t_m}\rho C \tag{15}$$

で求めることが出来る。

また,粉体が吸収する熱量は式(12)によって求める ことができ,照射エネルギーを前もって測定しておく ことにより,吸収率を計算できる。

2.2 熱伝導率と吸収率の実験的検討

2.2.1 熱伝導率

図4に実験装置の外観,図5に主要部を示す。直径 60mmの容器に金属粉末を満たし,粉末表面にレーザ 光を数秒間照射して加熱している。容器中心部の粉体 表面から深さzの位置には熱電対が埋め込まれてお り,粉体の温度上昇を測定することが出来る。図6に 熱電対からの出力波形を示す。図では,4秒間レーザ 照射を行っているが,およそ10秒後から温度が上昇し 始め, t_m =65秒程度で最高温度に到達し,以後ゆっく り低下している。 t_m の値を式(15)に代入することに より,粉体の熱伝導率を求めることが出来る。

図7に銅粉体の熱伝導率を示す。粉体の嵩比重が大 きくなるに従い熱伝導率は大きくなるが、それでも 高々0.6W/mKとバルク材の銅の390W/mKに比べて 非常に小さい。粉体間の空気の影響が非常に大きいと 考えることが出来る。

2.2.2 吸収率

吸収率は積分球を用いて測定している。積分球を図 8に示す。積分球の底部に置かれた粉体試料に,上部 からレーザ光を照射する。レーザ光の内,材料に吸収 されず粉体表面で反射したレーザ光は球面内部で反射 を繰り返し,最終的に積分球の横にある孔から取り出 され,光電変換素子によってそのエネルギー量が測定 される。供給したレーザエネルギーから反射されたエ ネルギーを差し引くことで,粉体に吸収されたエネル ギーを求めることが出来る。

その結果を図9に示す。波長1.06μmのNd:YAG レーザを用いているが,吸収率は20~30%程度ある ことがわかる。球形に近い形状(略球形)の粉末で 20%程度であるのに対し,形状がいびつな粉末では 30%程度であり,粉末形状がレーザの吸収率に影響 することがわかる。

参考に, CO₂レーザをステンレス粉末に照射した場 合の吸収率を,先の式(12)を適用して求めてみたとこ ろ,20% 程度の吸収率が得られ,粉体に対しては大 きな吸収率を示すことがわかる。



図4 実験装置外観







図7 粉体の嵩比重が熱伝導率に及ぼす影響



図8 積分球



3. 造形体の特性値

3.1 ヤング率と引っ張り強度

金属粉末をレーザ光によって結合する本手法では、 その強度が重要である。そこで、粉体を結合した SCM 混合体材のヤング率、及び引っ張り強度を測定 した結果を図10、図11に示す。

レーザ光の走査速度を調整して粉体の結合状態を調 節している。速度を遅くすることにより粉体は溶融し てしっかりと結合し,材料の気孔率はほぼゼロにな る。気孔率が小さくなるに従いヤング率は大きくな り,最大で500GPa程度となっている。

また,引っ張り強度も同様の傾向を示しており,気 孔率がほぼゼロの状態で600N/mm²となっており,十 分な引っ張り強度を持っていることがわかる。

3.2 熱伝導率

図12に SCM 混合材の造形物の熱伝導率を示す。気 孔率がほぼゼロで10W/mK の熱伝導率を持っている。 粉体状態における熱伝導率と比べれば、20倍程度の大 きな値であるが、SCM、ニッケル、銅のバルク材の



図12 レーザフラッシュ法による造形体の熱伝導率

熱伝導率が,それぞれ40W/mK,90W/mK,390W/mK であることを考えれば,はるかに小さな値であること がわかる。このことから,粉体の結合状態の改善によ り熱伝導率をバルク材の値に近づけることができれ ば,材料強度を向上できる可能性があることを示唆し ている。



3.3 寸法精度

一層の厚み50µmの粉末層にレーザ照射して結合 し、10回積層を行った後小径ボールエンドミルで切削 加工を行っている。すなわち,500 µ m の積層ごとに 一回の切削を行い、この操作を繰り返して造形物を製 作しており、寸法精度は十分に確保されている。しか し、粉体を高温に加熱しながら積層していくことか ら、造形物には引っ張りの残留応力が生じることにな り、熱ひずみの原因となっている。図13は、高さ6 mmの直方体造形物を厚さ10mmのベースプレート上 に積層したときに生じる残留応力を測定した結果であ る。造形物内部には引っ張りの残留応力が生じてお り、特に表面層とベースプレート境界部に大きな応力 が生じている。ベースプレートに厚みのある板材を使 う方法、レーザ光を照射する位置をランダムに支える ことによって熱を拡散する方法、収縮の小さい材料の 開発などによってその影響を抑える工夫がなされてい る。

4. おわりに

金属粉末光造形複合加工技術によって作られた金型 は、すでに生産現場で射出成形の量産金型として使わ れており、プラスチック製品の精度を十分確保できる レベルにまで到達している。レーザ加工と切削加工を 組み合わせた本加工技術には、複雑な金型を一体で製 作できること、金型の内部に冷却用の水管を自由に設 置できること、粉体の結合状態を調節することにより ポーラスな材質を作り出しベント機能を持たせられる ことなどの特長があり、今後、新たな粉体材料の開発 が進めばさらにその応用範囲が広がるものと考えてい る。

参考文献

 H. S. Carslaw, J. C. Jaeger : Conduction of Heat in Solids, Oxford at the Clarendon Press, 1959, 255.

Captions

- Fig. 1 SEM image of metal powder
- Fig. 2 Model of heat source
- Fig. 3 Model of Heating
- Fig. 4 Experimental set-up
- Fig. 5 Main part of experimental set-up
- Fig. 6 Output wave
- Fig. 7 Influence of Bulk density on thermal conductivity
- Fig. 8 Integrating sphere
- Fig. 9 Absorption of metal powder
- Fig. 10 Influence of porosity of consolidated material on Young's modulus
- Fig. 11 Influence of porosity of consolidated material on Tensile strength
- Fig. 12 Influence of porosity of consolidated material on thermal conductivity
- Fig. 13 Residual stress in consolidated material
- Table 1 Metal powder used